
歷史及公司架構

概覽

本公司的歷史可追溯至本公司前身創立的1970年代。因應前潮州市無線電瓷件廠重組，本公司其後於1992年12月成立為股份制公司。於2014年12月，本公司A股在深圳證券交易所創業板上市，股票代碼為300408.SZ。

本公司以深厚的「材料」基因為根基，確立「材料+結構+功能」的戰略發展方向，深耕先進電子陶瓷材料和零部件領域超55年。根據弗若斯特沙利文的資料，始終聚焦先進陶瓷材料主業的本公司，現已成長為先進電子陶瓷材料和零部件領域的全球領先企業。

里程碑

以下載列本公司主要業務發展里程碑的概要：

年份	里程碑
1992年	本公司成立為股份有限公司。
1996年	本公司投資生產用於片式電阻器的氧化鋁陶瓷基板，標誌著本公司邁進電子產業鏈上游基礎材料領域。
2000年	本公司開始研究MLCC產品。
2001年	本公司開發用於光通信的陶瓷器件，將其產品組合從電子應用擴展到光通信領域。
2005年	本公司開發SOFC隔膜片，進入新能源應用領域。
2006年	本公司開始研發陶瓷封裝基座，為晶振裝置提供核心材料。

歷史及公司架構

年份	里程碑
2009年	<p>本公司開發氮化鋁陶瓷基板，為半導體功率模組提供高效率的散熱管理解決方案。</p> <p>本公司成立南充三環，將生產基地拓展至四川省。</p>
2013年	<p>本公司成立其自有的研究院，為本公司的技術創新提供了強大的平台。</p>
2014年	<p>本公司A股在深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300408.SZ)。</p>
2015年	<p>本公司榮獲中國電子元件行業協會評為中國電子元件行業百強企業第七名。</p>
2016年	<p>本公司獲國家發展和改革委員會評為國家企業技術中心。</p>
2017年	<p>本公司完成收購微密斯德國，進一步拓展國際市場。</p>
2019年	<p>本公司於泰國成立全資子公司Glory Winner，進一步提升了海外產能。</p>
2020年	<p>本公司完成了A股配售，籌集所得款項用於5G通信用高品質MLCC擴產技術改造項目和半導體芯片封裝用陶瓷劈刀產業化項目。</p>
2021年	<p>本公司於中國成立全資子公司德陽三環，標誌著本公司的產能潛力進一步加強。</p> <p>本公司完成了A股配售，籌集所得款項用於大容量系列MLCC擴產項目和深圳研發基地建設項目。</p>

歷史及公司架構

年份	里程碑
2022年	<p>本公司成立蘇州研究院與成都研究院，分別作為其於華東地區與西南地區的重要研發基地。</p> <p>本公司的光纖陶瓷插芯及片式電阻器陶瓷基板獲中國工業和信息化部評為單項冠軍產品。</p>
2023年	<p>本公司推出精密陶瓷結構件，進軍泛半導體設備結構件領域。</p> <p>本公司開發了陶瓷髁關節部件。</p>
2024年	<p>本公司獲中國電子元件行業協會評為中國電子元器件骨干企業TOP100。</p>
2025年	<p>本公司獲中國工業和信息化部評為全國工業和信息化系統先進集體。</p>

主要子公司

以下載列於往績記錄期間對本集團經營業績作出重大貢獻的本公司子公司的主要業務活動、成立／註冊成立地點及成立／註冊成立日期。

子公司名稱	成立／註冊 成立地點	成立／註冊 成立日期	本公司 應佔股權	主要業務活動
南充三環	中國	2009年5月11日	100%	電子及陶瓷材料、電子元件及通信器件研發、製造及銷售

歷史及公司架構

子公司名稱	成立／註冊 成立地點	成立／註冊 成立日期	本公司 應佔股權	主要業務活動
德陽三環	中國	2021年3月26日	100%	電子元件、電子及陶瓷材料 及通信器件研發、製造及 銷售
香港三環	香港	2007年8月20日	100%	電子元件、電子及陶瓷材料、 通信器件進出口貿易
微密斯德國	德國	2009年9月14日	100% ^{附註}	壓電式微點膠系統的 研發、製造及銷售
Glory Winner	泰國	2019年7月12日	100%	電子元件、電子及陶瓷材料、 通信器件的製造及銷售

附註：

本集團於2022年前已收購微密斯德國及其子公司的96%股份。於2023年，本集團進一步收購微密斯德國餘下4%股份。截至最後實際可行日期，微密斯德國為本集團的全資子公司。

本公司的重大股權變動

成立及早期發展

於1992年12月10日，本公司根據中國法律成立為股份有限公司，初始註冊資本為人民幣60,000,000元，由前潮州市無線電瓷件廠改制而成。

歷史及公司架構

當時發起人完成認購及本公司註冊資本進行調整後，本公司由潮州市國有資產管理辦公室持有**36.37%**股份、中國工商銀行廣東省信託投資公司持有**5%**股份、潮州市金信房地產開發實業公司持有**5%**股份，及當時員工持有**20%**股份。

於**1994**年至**2014**年間，本公司進行了多輪增資、股份轉讓及資本公積轉增股本，完成後其註冊資本增加至人民幣**382,800,000**元。

2014年在深圳證券交易所創業板上市

於**2014**年**12**月，本公司**A**股在深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：**300408.SZ**)(**A**股上市)。

本公司**A**股上市發售合共**46,000,000**股**A**股，佔緊隨**A**股上市完成後本公司經擴大股本的**10.7%**。緊隨**A**股上市完成後，本公司股本增加至人民幣**428,800,000**元。

完成**A**股上市後，本公司註冊股本達**428,800,000**股，其中約**40.75%**由張先生直接及間接(透過三江投資)持有。

增資、實施員工股權激勵計劃及回購A股

於**2015**年**5**月及**2016**年**4**月，本公司以資本公積轉增股本的方式增加註冊資本。

於**2015**年**9**月、**2016**年**9**月、**2017**年**12**月及**2018**年**11**月，本公司實施兩項員工股權激勵計劃，分四批向合資格員工發行及授予限制性**A**股。

歷史及公司架構

自2016年11月至2020年5月，本公司回購及註銷若干先前根據該等員工股權激勵計劃授出的未歸屬限制性A股。

本公司股本完成上述變更後，本公司已發行股本總額為人民幣1,737,872,522元。

2020年配售A股

經臨時股東大會於2020年3月及中國證監會於2020年9月批准，本公司就其A股進行配售，以籌集資金用於5G通信用高品質MLCC擴產技術改造項目和半導體芯片封裝用陶瓷劈刀產業化項目（「2020年A股配售」）。

2020年通過A股配售向11名獨立第三方投資者發行合共79,033,430股A股，所得款項淨額約為人民幣2,153.6百萬元。2020年A股配售完成後，本公司已發行股本總額增加至人民幣1,816,905,952元。

2021年配售A股

經股東大會於2021年6月及中國證監會於2021年10月批准，本公司就其A股進行配售，以籌集資金用於本集團大容量系列MLCC擴產項目及深圳三環研發基地建設項目（「2021年A股配售」）。

2021年通過A股配售向20名獨立第三方投資者發行合共99,591,419股A股，所得款項淨額約為人民幣3,879.8百萬元。2021年A股配售完成後，本公司已發行股本總額增加至人民幣1,916,497,371元。

重大收購、合併及出售

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並無進行任何重大收購、合併或出售。

歷史及公司架構

於深圳證券交易所創業板上市及H股[編纂]的理由

自2014年12月起，本公司A股已於深圳證券交易所創業板上市。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並無發生重大違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。據董事所了解，本公司在深圳證券交易所的合規紀錄並無任何重大事宜須敦請聯交所或[編纂]的潛在投資者垂注。中國法律顧問認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並無重大違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查及中國法律顧問的上述意見，獨家保薦人並無注意到任何重大事項，將導致彼等不同意董事就本公司在深圳證券交易所的合規紀錄所作出的確認。

本公司尋求其H股在聯交所[編纂]，以深化全球化戰略佈局、拓寬海外融資渠道、支持海外項目開發及提升核心競爭力。更多詳情請參閱本文件「業務 — 戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

公眾持股量及自由流通量

根據上市規則第8.08(1)及19A.13A條，由於本公司擁有除尋求[編纂]的H股以外的其他股份，故於[編纂]時由公眾人士所持有尋求[編纂]的H股須(a)佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股)至少10%；或(b)預期市值不低於30億港元。

根據[編纂]將予發行的H股總數約佔本公司已發行股本總額的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且不包括截至最後實際可行日期本公司購回作為庫存股份的5,133,800股A股)。預期於[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)，(i)按[編纂]每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的最低[編纂])計算，緊隨[編纂]後我們股份的市值預期為[編纂]百萬港元；(ii)按[編纂]每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)計算，緊隨[編纂]後我們股份的市值預期為[編

歷史及公司架構

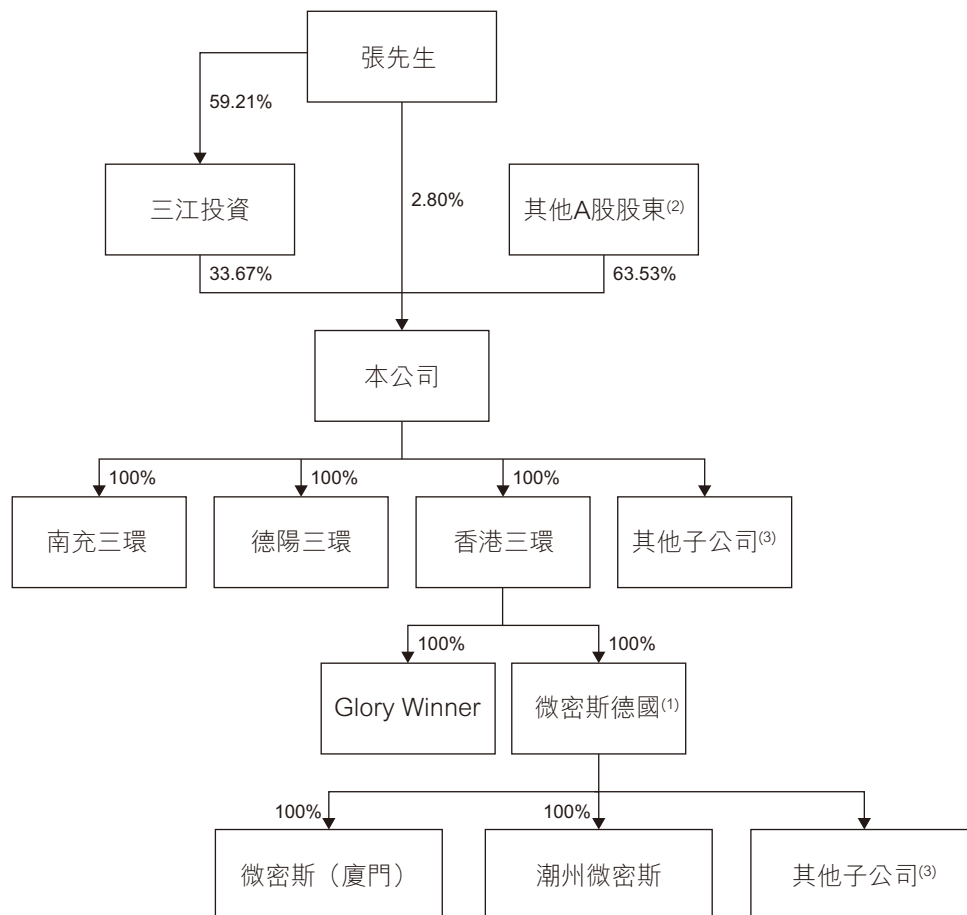
纂]百萬港元；及(iii)按[編纂]每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的最高[編纂])計算，緊隨[編纂]後我們股份的市值預期為[編纂]百萬港元，從而符合上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)的規定。

根據[編纂]每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)，本公司將符合上市規則第8.08A條(經第19A.13C條修訂及取代)項下的自由流通量規定。

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]前本集團的股權及公司架構：



附註：

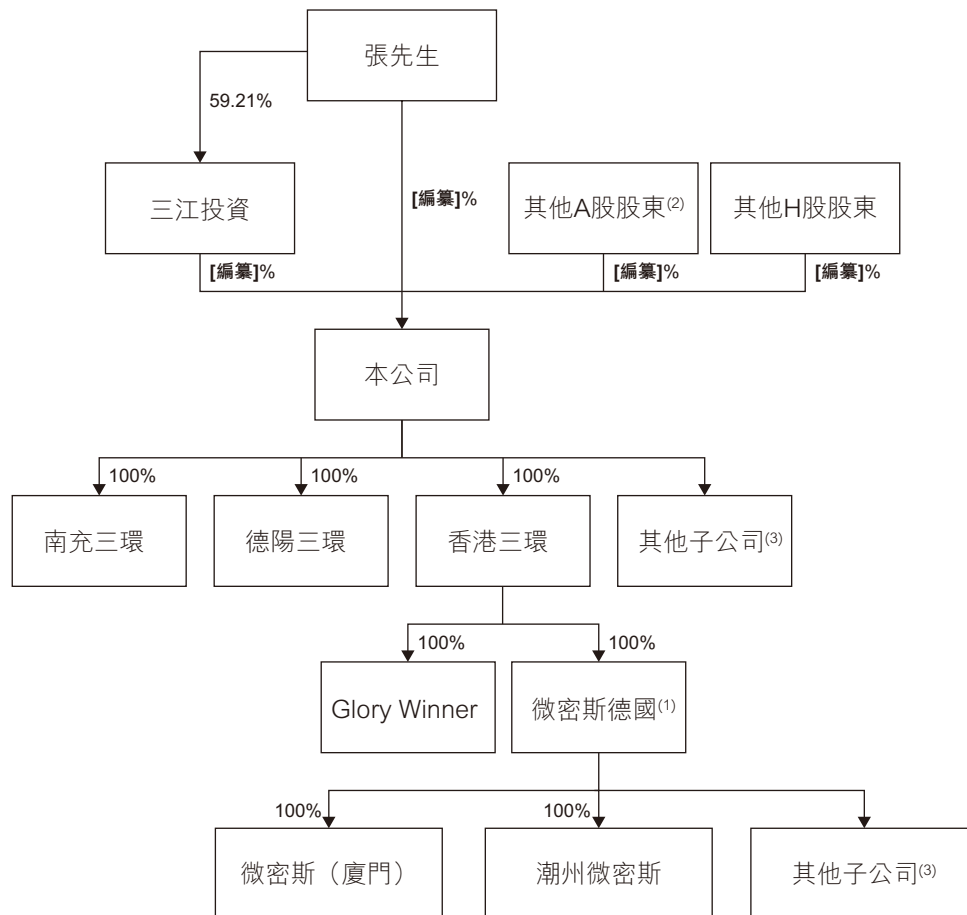
- (1) 截至最後實際可行日期，本公司透過多家全資子公司間接全資擁有微密斯德國權益。
- (2) 截至最後實際可行日期，本公司持有5,133,800股A股作為庫存股，該等股份不附有任何股東權利，包括但不限於在股東會投票及收取股利的權利。

歷史及公司架構

- (3) 其他子公司包括(1)截至最後實際可行日期在不同司法管轄區成立的13家全資子公司；(2)廣東省先進陶瓷材料科技有限公司，由本公司、廣東四通陶瓷有限公司(一名獨立第三方)、塗溶(一名獨立第三方)、武漢理工大產業集團有限公司(一名獨立第三方)、陳雲(一名獨立第三方)及廣東工大資產經營有限公司(一名獨立第三方)分別直接及間接擁有86.23%、5.39%、2.69%、2.69%、1.99%及1%權益；及(3)VERMES Microdispensing India Pvt. Ltd.，由本公司及VERMES Microdispensing India Pvt. Ltd.的總經理Stefan Michael Hirte分別擁有99.99%及0.01%權益。

緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)本集團的股權及公司架構：



附註：

(1)-(3) 見本節「— 公司架構 — 緊接[編纂]前的公司架構」。